

PEGAMENTO EN BARRA PARA PLACA DE CONSTRUCCIÓN DE MODELOS P1P, P1S Y X1C

SGL001



Descripción:

Barra de pegamento para la placa de construcción de impresoras 3D Bambu Lab Series P1P, P1S y X1C. Diseñada para proporcionar una adhesión óptima entre la superficie de impresión y el modelo. Además, no contiene formaldehído, garantizando un uso seguro.

Especificaciones del producto:

Descripción	Unidad	
Aplicación	-	PLA/ABS/PETG/PC/PA/TPU
Característica	-	Disoluble en agua
Ciclo vital	-	24 meses
Tamaño del paquete	mm	105x55x33
Peso del paquete	gr	50
Color	-	50

Guía de usuario:

Aplique uniformemente sobre la placa de impresión limpia antes de imprimir y cubra todas las áreas de impresión. Lave la placa después de terminar la impresión.

Nota:

¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños menores de 3 años y guárdelas en un lugar fresco y seco.



AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Francisco Javier Hernández Ramos
Revisó	Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez
Fecha	20/01/2025

